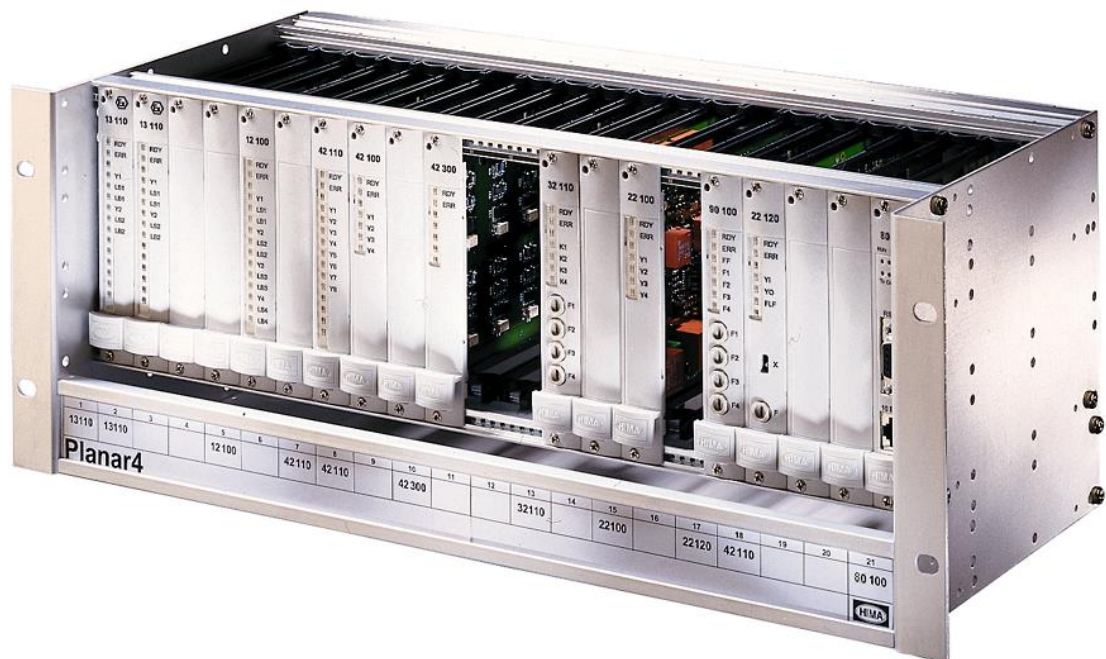




## 90 901: Baugruppenträger mit Busplatine

für (Ex)i-Baugruppen des HIMA Planar4 Systems

Anschlüsse: Löttechnik



Lieferung ohne Baugruppen

Bild 1: Baugruppenträger

Der Baugruppenträger wird nur für das HIMA Planar4 System eingesetzt. Auf den Steckplätzen 1 ... 20 können (Ex)i-Baugruppen des Planar4 Systems gesteckt werden, Platz 21 ist für die Kommunikationsbaugruppe reserviert.

Die Busplatine auf der Rückseite enthält Federleisten, Anschlussleisten (Löttechnik) und die für eine Funktion notwendige Busstruktur:

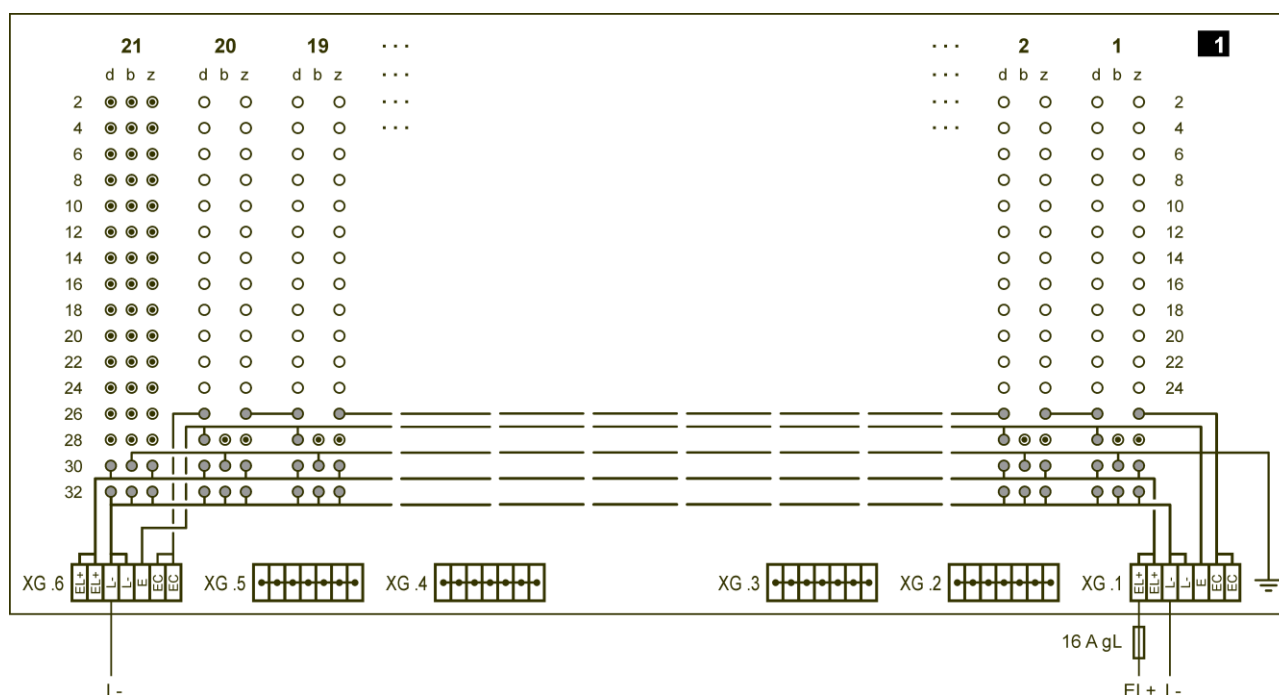
- Verbindungen für die interne Kommunikation.
- Spannungsversorgung 24 VDC.
- Sammelschiene und Kontaktschleife für die Fehlersignale.
- Für das Datenverbindungskabel der Kommunikationsbaugruppe ist eine Durchführung nach hinten auf die Verdrahtungsebene vorhanden.

Der Baugruppenträger ist komplett montiert einschließlich Beschriftungsfeld vorn, Verdrahtungsschutzhauben und zwei Verdrahtungskanälen auf der Rückseite.

Material	Aluminium, chromatiert
Breite	482,6 mm (19 Zoll)
Höhe	177 mm (4 HE)
Tiefe	270 mm
Teilungseinheiten	84 TE (1 TE = 5,08 mm)
Baugruppen	Nach DIN 41494, jeweils 4 TE
Steckverbinder	Nach DIN 41612, Bauform F, mit Reihen z und d
Anschlussart	Löten
Masse	Ca. 3,5 kg

## Prinzip der Busplatine

Ansicht von der Rückseite



- 1** Steckplatznummer
- Anschluss für Funktionsverdrahtung
- Verbindung auf Busplatine
- ⊙ belegt für Kommunikation
- E Schiene für Fehlersignal ERR
- EC Kontaktschleife für Fehlersignal

Bild 2: Busplatine des Baugruppenträgers, Prinzipdarstellung

Der Anschluss der Versorgungsspannung EL+ erfolgt ohne Verwendung einer Sicherungsbaugruppe direkt über eine Sicherung von max. 16 A (Drahtquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>). Aus Sicherheitsgründen muss der Bezugspol L- von zwei getrennten Klemmen der Verteilung L- auf beiden Steckklemmenblöcken XG .1 und XG .6 angeschlossen werden (Ringleitung).

Die zweiten Anschlussklemmen für EL+ und L- auf XG .1 und XG .6 sollen nicht zur Speisung weiterer Baugruppenträger verwendet werden, um hohe Summenströme zu vermeiden.

Die Steckklemmenblöcke XG .2, XG .3, XG .4 und XG .5 sind potentialfrei; die Anschlussstifte eines Blocks sind auf der Platine gebrückt. Die Blöcke können nach Bedarf verwendet werden. Für die Versorgung von Leistungsausgängen über die Steckklemmenblöcke XG .2 bis XG .5 sollen für L+ und L- eigene Versorgungsleitungen mit geeigneten Querschnitten verwendet werden (siehe auch Kapitel «Verdrahtung der Baugruppenträger» im Systemhandbuch). Die Strombelastung ist auf max. 16 A begrenzt.

Um die mechanische Belastung der Lötstellen an den Anschlussstiften gering zu halten, sollten die Steckklemmenblöcke zum Anschließen oder Entfernen von Drähten aus der Fassung herausgezogen werden.

Die Erdungsanschlüsse b30 sind mit den Metallteilen des Baugruppenträgers elektrisch leitend verbunden. Die Anschlüsse z28, b28, d28, z30...d32 der rückseitigen Anschlussleisten sind nicht mit der Busplatine verbunden.

Bei Verwendung der Kontaktschleife für das Fehlersignal müssen die Anschlüsse z26-d26 auf nicht benutzten Steckplätzen gebrückt oder mit einer der Klemmen EC verbunden werden.

Anschlussleisten (Ex)i      28-polig, Teilenummer. 52.002 8420

---

**i**

Wird auf die Möglichkeit der Datenübertragung verzichtet, können für das Planar4 System auch Standard-Baugruppenträger mit 28-poligen Federleisten verwendet werden.

---

